



メディア連絡先：
Martijn Pierik
Impress Public Relations
602.366.5599
martijn@impress-pr.com

会社連絡先：
Scott Foster
OmniVision Technologies
408.567.3077
sfoster@ovt.com

投資家向け広報：
Brian M. Dunn
OmniVision Technologies
408.653.3263
invest@ovt.com

OmniVision が第 2 世代のバックサイドイルミネーションピクセル 技術を発表

*新登場の 1.1-MICRON OMNIBSI-2 テクノロジーは、これからの
携帯イメージングにおける品質と機能性の向上を可能にします*

サンタクララ (カリフォルニア州) – 2010 年 2 月 8 日 – 最先端のデジタルイメージングソリューション開発で大手の OmniVision Technologies, Inc. (ナスダック: OVTI) は、本日、世界初となる 1.1 ミクロンのバックサイドイルミネーション (BSI) ピクセルの採用を発表しました。新しい OmniBSI-2™ ピクセルアーキテクチャーはデジタルイメージングテクノロジーの分野では主要なマイルストーンと位置付けられ、上級の画像品質と高い低照度特性を備えた新たなイメージングソリューションを実現します。また、このアーキテクチャーは OmniVision のピクセルロードマップをサブミクロンレベルにまで拡張し、デジタルイメージングテクノロジーの継続的な小型化の主な実現手段としての役割を果たします。

OmniVision 社のワールドワイドマーケティングを担当する Bruce Weyer によれば、「OmniBSI-2 は、画期的に小さくした面積で、高さ方向を縮小した事により超薄型製品を可能にする高解像度のイメージセンサーソリューションの開発を可能にします。」 「OmniBSI-2 は、ビデオベースのアプリケーションでユーザの今までの考え方を大きく変える画像品質と高感度低照度特性により、デジタルイメージング市場を前進させることでしょう。」 「さらに、OmniBSI-2 特性テクノロジーは、現在の BSI や FSI といったイメージングセンサーを越える高性能を実現するために、より大きなピクセルデザインにも応用できます。

OmniBSI-2 は OmniVision 社の第 2 世代 BSI テクノロジーです。この技術は、300 mm の Cu 配線プロセスを使用した初のピクセルであり、戦略的な製造パートナーである Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) との協力の基に開発された 65 nm のデザインルールで設計されています。カスタムの 65 nm のデザインルールと新しい製造プロセスモジュールを組み合わせることで、1.1 ミクロンの OmniBSI-2 ピクセルは業界最先端の低照度感度を達成するとともに、暗電流の大幅な減少と大きな飽和特性を実現しています。OmniBSI-2 のカスタムピクセルデザインルールはさらに、より優れたピクセルレイアウト、分離特性

を備え、**混色**も大幅に抑えることができました。このような進歩は第 1 世代となる OmniBSI™ テクノロジーからのほ
るかな改善を意味し、画像品質の改善、色再現の改善、カメラ性能の向上など、多様な結果をもたらしました。

「比較してみると、新しい 1.1 ミクロン OmniBSI-2 ピクセルは、現在の 1.75 ミクロンの FSI アーキテクチャーより性能が優れている
だけでなく、現在、大量生産されている業界最先端の 1.4 ミクロン BSI ピクセルの性能と同等の性能が認められます。」

OmniVision のプロセス**開発を務める副社長の** Dr. Howard Rhodes は次のように述べています。「1.1 ミクロン BSI ピクセル
ルアーキテクチャーへ移行するためには、製造自体を TSMC の最新の 300mm **Cu配線**プロセスへ移す必要がありま
した。これにより、設計ルールが大幅に改善され、より新しい**製造装置**を使用できるようになりました。この結果、プ
ロセス制御をより緊密に行い、欠陥密度の改善に成功しました。当社の成功のカギは、OmniVision と TSMC
R&D チームによる協力開発体制にあったと言えます。ここで開発された新しいプロセスモジュールにより、**イメージセン
サ技術** が大幅に改良されました。OmniVision ではさらに、合同のベンチャーパートナーである VisEra
Technologies と密接なパートナーシップを築き、300mm のカラーフィルターの製造性能を確立しました。」

「OmniVision と TSMC は CMOS イメージセンサー開発において、長期にわたりパートナー関係を
維持しています。エンジニアリングチームは力を合わせてデジタルイメージングの限界を広げ、卓越した開発および製造パー
トナーとしての関係を育んできました。」TSMC North America、副社長、Sajiv Dalal はこのように述べています。「OmniVision
において、300mm の製造への製品移行により、OmniVision の競争力が高められました。私たちは今後もその差をさ
らに広げることができるよう、引き続き効率性の改善をはかります。」

TSMC は半導体部門の最先端 CIS テクノロジーと最大の CIS 生産設備を提供します。2009 年、TSMC **8インチ換算で
おおよそ1000万枚のウエハー**、2008 年の製造能力比 6 % 増と、総合的にサポートしました。Dr.Rodes は次のように
付け加えました。「TSMC はこの先進的なプロセスノードに移行する上で、重要なパートナーと言えます。先進技術ノードでの
300 mm プロセスにおける彼らの経験と専門性、そして、センサー性能を持続的に向上する能力は、この新しいピクセルテクノロジ
ーをこのようにすばやく、シームレスに進める上で不可欠でした。」

OmniVision の新しい OmniBSI-2 テクノロジーは、2010 年、スペインのバルセロナで 2 月 14 日か
ら 18 日まで開催される Mobile World Congress にてお客様にご紹介いたします（要予約）。

OmniBSI テクノロジーについて

OmniBSI と OmniBSI-2 は、従来の CMOS 画素アーキテクチャーよりも**画期的に変えた技術**アプローチを採用した CMOS イメージセンサー (CIS) の大量生産における革新的技術です。OmniBSI テクノロジーは、感度、色再現性、および画像品質の持続的な改善を掲げ、将来的な CIS アーキテクチャーの基礎を提供します。その一方で、0.9 ミクロンピクセル以下までの**開発**にも取り組んでいます。

OmniBSI 技術では、センサーのバックサイドから集光できるように、イメージセンサーを裏返しにして、ピクセルのバックサイドに色フィルターおよびマイクロレンズを**形成しています**。レイヤの配列が効果的に逆になります。これにより、金属と絶縁体層をセンサーアレイの下にすることにより、光をピクセルに**直接的に入射**でき、クラス最高の低照度感度、画像品質、および色再現性も提供します。

OmniVision について

OmniVision Technologies (NASDAQ: OVTI) は、高度デジタル画像ソリューション開発の先進企業です。受賞暦のある CMOS イメージングテクノロジーにより、携帯電話、ノートパソコン、ネットブック、Web カメラ、デジタル静止カメラ、デジタルビデオカメラ、セキュリティ/サーベルランス、エンターテインメントデバイス、自動車、医療用イメージングシステムなどの今日の一般消費者/商用アプリケーションにおいて、優れた画像品質を実現しています。詳細については、www.ovt.com をご覧ください。

免責条項

OmniBSI-2 テクノロジーの予測される利点、性能、機能、大量生産の需要と期間に関する記述を含め、このプレスリリースに含まれる特定の記述は、リスクと不確実性を伴う「将来予想に関する記述」です。これらの将来予想と OmniVision において実際に生じる結果は大きく異なる可能性があります。その要因としては以下が含まれますが、これらに限定されません: OmniBSI-2 に関する潜在的エラー、設計上の瑕疵、その他の問題、顧客の支持、需要、OmniVision の証券取引委員会へ提出した報告書とレポートに随時記述されるその他のリスク。これらの報告やレポートには、10-K フォームによる OmniVision の年次報告、10-Q フォームによる四半期報告が含まれますが、これらに限定されません。OmniVision はあらゆる将来予想に関する記述の情報を更新する義務を明確に放棄します。

OmniVision® は OmniVision Technologies, Inc の登録商標です。OmniVision のロゴ、OmniBSI™ および OmniBSI-2™ は OmniVision Technologies, Inc の商標です。他の商標はそれぞれの該当する所有者が権利を所有しています。

#